

発明名称： はんだボールグリッド配列パッケージの中に使用された一種のフリップ・チップ  
マルチチップモジュール基板

**A kind of flip-chip multi-chip module substrate used in solder ball grid array package**

発明名称：	はんだボールグリッド配列パッケージの中に使用された一種のフリップ・チップマルチチップモジュール基板
専利証書番号：	149000
出願番号：	087118149
出願日：	1998/10/30
公開番号：	471082

説明

A kind of flip-chip multi-chip module substrate used in solder ball grid array package uses the same substrate material as that used for integrated circuit to manufacture the base stand required by a multi-chip module. Additionally, its specific operation manner is developed to reach the effects of mass production. The present invention contains two major parts: the manufacturing process and method of base stand; and the flip-chip solder ball grid array package process. These two major parts can be independently operated or connected in series to have continuous operation.



